公司代码:688981　　公司简称:中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司

【2020】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第五节经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”。

3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度拟不进行利润分配,该议案尚需提交2021年股东周年大会审议。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

√适用 □不适用

公司治理特殊安排情况:

√本公司为红筹企业

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所科创板	中芯国际	688981	不适用
港股	香港联交所主板	中芯国际	00981	不适用

公司存托凭证简况

√适用 □不适用

公司存托凭证简况						
证券种类	存托凭证与基础股票的转换比例	存托凭证上市交易所及板块	存托凭证简称	存托凭证代码	变更前存托凭证简称
美国预托证券(注1)	1:5	美国场外市场	中芯国际美国预托证券	SMICY	不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	郭光莉	李蕾
办公地址	中国上海市浦东新区张江路18号	中国上海市浦东新区张江路18号
电话	021-20812800	021-20812800
电子信箱	ir@smics.com	ir@smics.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业,主要为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。

公司集成电路晶圆代工业务系以8英寸或12英寸的晶圆为基础,运用数百种专用设备和材料,基于精心设计的工艺整合方案,经上千道工艺步骤,在晶圆上构建复杂精密的物理结构,实现客户设计的电路图形及功能。公司成功开发了0.35微米至14纳米多种技术节点,应用于不同工艺平台,具备逻辑电路、电源/模拟、高压驱动、嵌入式非挥发性存储、非易失性存储、混合信号/射频、图像传感器等多个工艺平台的量产能力,可为客户提供智能手机、智能家居、消费电子等不同终端应用领域的集成电路晶圆代工及配套服务。

除集成电路晶圆代工外,公司亦致力于打造平台式的生态服务模式,为客户提供设计服务与IP支持、光掩模制造、凸块加工及测试等一站式配套服务,并促进集成电路产业链的上下游合作,与产业链各环节的合作伙伴一同为客户提供全方位的集成电路解决方案。

2020年,公司产能稳步扩充,产能利用率维持高位,基于多元化的工艺节点、全方位的配套技术服务,满足客户差异化需求,持续为客户创造更高的附加价值,全力服务于境内外的广大客户。

(二) 主要经营模式

1. 盈利模式

公司主要从事基于多种技术节点的、不同技术平台的集成电路晶圆代工业务,以及设计服务与IP支持、光掩模制造、凸块加工及测试等配套服务。

2. 研发模式

公司形成了完整、高效的创新机制,建立了完善的研发流程管理制度。公司具备专业的研发团队,建立了完善的研发流程与先进的研发支撑体系,持续对成熟制程、先进制程和特殊工艺的研发投入,夯实了技术基础,构建了技术壁垒,并确保研发项目成功转化。研发流程主要包括项目选择、可行性评估、项目立项、技术开发、技术验证、产品验证和产品投产七个阶段,每个阶段均有严格的审批流程。

3. 采购模式

公司主要向供应商采购集成电路晶圆代工及配套服务所需的物料、设备及技术服务等。为提高生产效率、加强成本控制,公司建立了采购管理体系。公司拥有成熟的供应商管理体系与较为完善的供应链安全体系,建立了供应商准入机制、供应商考核与评价机制及供应商能力发展与提升机制,在与主要供应商保持长期合作关系的同时,兼顾新供应商的导入与培养,加强供应链的稳定与安全。

4. 生产模式

公司按市场需求规划产能,并按计划进行投产,具体如下:

1. 小批量试产:客户按照公司提供的设计规则进行产品设计。设计完成后,公司根据客户的产品要求进行小批量试产。

2. 风险量产:小批量试产后的样品经封装测试、功能验证等环节,如符合市场要求,则进入风险量产阶段。风险量产阶段主要包括产品良率提升、生产工艺能力提升、生产产能拓展等。

3. 批量生产:风险量产阶段完成且上述各项变付指标达标后,进入批量生产阶段。在批量生产阶段,销售部门与客户确认采购订单量,生产计划部门根据客户订单需求安排生产、跟踪生产进度并向客户提供生产进度报告。

4. 营销及销售模式

公司采用多种营销方式,积极通过各种渠道拓展客户。公司通过市场研究,主动联系并拜访目标客户,推介与客户匹配的工艺和服务,进而展开一系列的客户拓展活动。公司通过与设计服务公司、IP供应商、EDA厂商、封装测试厂商、行业协会及各集成电路产业促进中心合作,与客户建立合作关系。公司通过主办技术研讨会等活动或参与半导体行业各种专业会展、峰会、论坛进行推广活动并获取客户。部分客户通过公司网站、口碑传播等公开渠道联系公司寻求直接合作。公司销售团队与客户签订订单,并根据订单要求提供集成电路晶圆代工以及相关配套服务,制作完成的产品最终将被发货至客户或其指定的下游封装、测试厂商。公司通过上述营销方式与客户建立合作关系后,将与客户直接沟通并形成符合客户需求的解决方案。

公司结合市场供需情况、上下游发展状况、公司主营业务、主要产品、核心技术、自身发展阶段等因素,形成了目前的晶圆代工模式。报告期内,上述经营模式的关键因素未发生重大变化。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

集成电路产业链中的核心产业是集成电路设计,制造和封装测试。受益于物联网,云计算与大数据等相关产品需求成长,集成电路产业目前已成为支撑经济社会发展的基础性和先导性产业,其发展程度成为科技发展水平的核心指标之一,影响着社会信息化进程。

2020年,伴随全球地缘贸易关系紧张和疫情持续蔓延的影响,产业链的不确定性正在进一步扩大。尽管全球宏观经济增长放缓,集成电路市场依然维持逆势增长。其中,物联网、云计算、大数据等相关产品已逐渐从爬坡期进入成熟期,需求量进入稳定成长阶段。人工智能、驾驶辅助、机器人和无人机等领域也处于积极迭代发展期,为全球集成电路产业孕育新的机遇。与此同时,疫情持续蔓延正逐渐改变人们传统的工作,学习和社交方式。消费群体对各类远程办公,教学和数据中心的接纳度有所提升。相关的终端智能设备,无线穿戴设备以及数据中心设备的需求向好。世界半导体贸易统计组织(“WSTS”)2021年3月公布的报告显示,2020年全球半导体销售额达达4,404亿美元,同比增长6.8%;2021年预计可达4,883亿美元,同比增长10.9%。

从国内产业发展情况看,受益于国内疫情的及时防控,产业链及时复工复产,同时配合基础电信、设备制造等多主体协同推进态势正加速形成,中国集成电路产业继续保持两位数增长。根据中国半导体行业协会统计,2020年中国集成电路产业销售额为8,848亿元,同比增长17%。其中,设计业销售额为3,778亿元,同比增长23.3%;制造业销售额为2,560亿元,同比增长19.1%;封装测试业销售额2,510亿元,同比增长6.8%。另外,根据海关统计,2020年中国进口集成电路5,435亿块,同比增长22.1%;进口金额3,500亿美元,同比增长14.6%。2020年中国集成电路出口2,598亿块,同比增长18.8%,出口金额1,166亿美元,同比增长14.8%。综合来看,国内的集成电路行业急需拓展产品的多元化,进一步配套完善产业链结构。

集成电路制造是集成电路三大核心产业之一。晶圆代工是集成电路制造企业的一种经营模式,是高度技术密集、人才密集、资金密集的行业。其对生产环境、能源、原材料、设备和质量管理体系等有非常严格的要求和执行规范。晶圆代工的研发生产过程涉及材料学、化学、半导体物理、光学、微电子、量子力学等诸多学科,需要专业的技术团队与强大的研发能力进行整合集成。一直以来,集成电路产品不断追求低功耗、小体积、多功能和高可靠性,对晶圆代工工艺的技术提出越来越高的要求,相应的半导体材料、设备、器件结构、工艺监测等细分技术领域都随之产生变革,所需资金投入巨大。伴随集成电路应用领域不断细分和延展,新兴产品的市场导入期持续缩短,晶圆代工企业的平台研发和平台升级周期也被赋予更高的预期。与此同时,晶圆代工厂的产能规模化也成为客户考量供应链稳定性的重要因素之一。伴随不断涌现的产品差异化需求,晶圆代工企业的配套服务已然成为企业吸引客户的附加优势,其中包括前期的辅助设计与IP支持、光掩模制造,以及后期的凸块加工、一站式封装测试等。综合来看,随着集成电路产品的应用领域更加多元化,晶圆代工行业的技术壁垒也越来越高。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业。根据IC Insights公布的2020年纯晶圆代工行业全球市场销售额排名,中芯国际位居全球第四位,在中国大陆企业中排名第一。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

集成电路制造需要在高度精密的设备下进行,在经历数十年的发展后,集成电路已由本世纪初的0.35微米的CMOS工艺发展至纳米级FinFET工艺。全球最先进的量产集成电路制造工艺已经达到5纳米,3纳米技术有望在2022年前后进入市场。

近年来,随着新兴应用的推陈出新,对除逻辑电路以外的其他集成电路和半导体器件类型也提出了更高的要求,驱动工艺不断升级。高速非易失性存储从最早的8Mb快速成长至如今的48纳米工艺节点256Mb。嵌入式非挥发性存储芯片从0.18微米迅速发展到40纳米的工艺节点,向着面积更小、速度更快的方向前进。

集成电路技术的不断发展也推动了设计服务领域的技术革新。随着FinFET DTCO技术的推出,设计服务可以与工艺开发深度协同,从设计的角度对工艺设计规则、后端布线规则、器件种类等进行优化,基于优化成果提供更好的设计服务,令其产品更具竞争力。

光掩模作为集成电路制造中光刻环节必不可少的核心工具,其制造技术的发展随着光刻技术的发展而演变。光掩模的类型从早期的二元掩模发展成相位移掩模,其图形传递介质从金属铬进化成钼硅材料。

集成电路封装作为集成电路产业链中不可或缺的环节,一直伴随着集成电路工艺技术的不断发展而变化。传统封装形式主要是利用引线框架或基板作为载体,采用引线键合互连的形式使电路与外部器件实现连接。随着集成电路制造工艺技术的不断发展,对端口密度、信号延迟及封装体积等提出了越来越高的要求,促进了先进封装如凸块、倒装、硅穿孔、2.5D、3D等新型封装工艺及封装形式的出现和发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:千元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	204,601,654	114,817,063	78.2	98,844,871
营业收入	27,470,709	22,017,883	24.8	23,016,707
归属于上市公司股东的净利润	4,332,270	1,793,764	141.5	747,278
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,696,902	-522,095		-616,854
归属于上市公司股东的净资产	99,128,037	43,573,354	127.5	41,158,317
经营活动产生的现金流量净额	13,174,290	8,139,992	61.8	5,209,909
基本每股收益(元/股)	0.67	0.34	97.1	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.33	93.9	0.14
加权平均净资产收益率(%)	6.29	4.3	增加2.0个百分点	2.0
研发投入占营业收入的比例(%)	0.017	0.0215	减少4.5个百分点	0.0194

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:千元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	6,401,136	6,760,363	7,638,160	6,671,050
归属于上市公司股东的净利润	436,632	949,774	1,693,783	1,252,081
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	142,580	399,334	1,114,516	40,472
经营活动产生的现金流量净额	1,531,895	1,561,860	5,704,232	4,376,303

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	385,097
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	374,119
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	880,354,855	4,269,360,976	55.42			未知		未知
中国信息通信科技集团有限公司及相关权益人	72,470,855	931,993,450	12.10	72,470,855	72,470,855	无		国有法人
鑫芯(香港)投资有限公司	-175,000,000	622,054,901	8.07			无		境外法人
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	127,458,120	127,458,120	1.65	127,458,120	127,458,120	无		未知
GIC PRIVATE LIMITED	110,443,730	110,443,730	1.43	109,249,819	109,249,819	无		境外法人
青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)	80,589,949	80,589,949	1.05	80,589,949	80,589,949	无		其他
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	55,727,380	55,727,380	0.72			无		其他
中国保险投资基金(有限合伙)	54,624,908	54,624,908	0.71	54,624,908	54,624,908	无		其他
国新投资有限公司	36,416,605	36,416,605	0.47	36,416,605	36,416,605	无		国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	36,416,605	36,416,605	0.47	36,416,605	36,416,605	无		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 □不适用

5 公司债券情况

□适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所

5.2 公司债券付息兑付情况

□适用 □不适用

5.3 公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 □不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)			
EBITDA全部债务比			
利息保障倍数			

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

于2020年,本集团的营业收入共达27,470.7百万元,于2019年则为22,017.9百万元。本集团于2020年净利润为4,021.3百万元,较2019年的1,268.5百万元增加217.0%。于2020年,本集团的经营活动所得现金为13,174.3百万元,较2019年的8,140.0百万元增加61.8%。2020年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金共有37,168.2百万元,而2019年则为12,722.8百万元。前瞻未来,我们的长期目标是持续获利。为达成此项目标,我们将着力于精确执行、改善效能、维持一流的客户服务,以及实现创新。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。截至2019年12月31日止年度及截至2020年12月31日止年度纳入合并范围的主要子公司详见本节“九、1在子公司中的权益”。

A股代码:688981　A股简称:中芯国际　公告编号:2021-008

港股代码:00981　港股简称:中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司关于2021年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称“中芯国际”或“公司”)于2021年3月31日召开董事会审议通过了《关于2021年度日常关联交易额度预计的议案》,关联董事周子学、赵海军、高永岗回避表决本议案,出席会议的非关联董事一致同意该议案。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《经修订及重述组织章程大纲及章程细则》、《关联(连)交易管理制度》等相关规定,本次关联交易事项未达到股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

(二)2021年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况,公司2021年度日常关联交易预计额度约为753,271千元,具体情况如下:

单位:人民币千元

关联人	关联交易类别	2021年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2021年2月28日与关联人累计已发生的交易金额	2020年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
盛吉盛(宁波)半导体科技有限公司	采购货物	4,746	0.0%	-	2,393	0.0%	
	向关联方买入机器设备	205,084	0.5%	153	114,597	0.3%	
	小计	209,830		153	116,990		
江苏长电科技股份有限公司	接受劳务	60,000	0.8%	6,556	53,383	0.7%	
	向关联方租入资产	3,900	0.6%	547	3,324	0.5%	
	小计	63,900		7,103	56,707		
中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司	接受劳务	2,748	0.0%	-	6,377	0.1%	
	向关联方出租资产	3,682	2.2%	931	1,179	0.7%	
	小计	6,430		931	7,556		
凸版中芯彩晶电子(上海)有限公司	采购货物	54,624	0.3%	8,332	61,662	0.4%	
	接受劳务	700	0.0%	9	651	0.0%	
	向关联方出租资产	31,862	19.4%	4,960	28,759	17.5%	
	小计	87,186		13,301	91,072		
灿芯半导体(上海)股份有限公司	销售货物	385,925	1.6%	81,673	208,901	0.9%	
总计		753,271		103,161	481,226		

注1:上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2020年度经审计同类业务的发生额。

注2:上述预计额度允许在同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1. 盛吉盛(宁波)半导体科技有限公司

公司名称	盛吉盛(宁波)半导体科技有限公司
公司性质	有限责任公司(中外合资)
法定代表人	项习飞
注册资本	3,209.52万美元
成立日期	2018年3月22日
住所/主要办公地点	浙江省宁波市鄞州区云龙镇石桥村
主营业务	半导体设备及配件的研发、翻新改造安装维护销售
主要股东或实际控制人	中芯国际控股有限公司:持股比例18.69% 上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙):持股比例18.17% TRIPLECORE3 KOREA CO.,LTD.:持股比例15.58% 芯鑫融资租赁有限责任公司:持股比例15.58% 上海新阳半导体材料股份有限公司:持股比例13.28% 芯空间控股有限公司:持股比例12.46% 天津吉盛管理咨询合伙企业(有限合伙):持股比例6.23%

2. 江苏长电科技股份有限公司

公司名称	江苏长电科技股份有限公司
公司性质	股份有限公司(上市公司)
法定代表人	郑力
注册资本	160,287.456万人民币
成立日期	1998年11月6日
住所/主要办公地点	江苏省无锡市江阴市滨江中路275号
主营业务	集成电路的系统集成封装设计与特性仿真、晶圆中道封装及测试、系统级封装测试、芯片成品测试服务
主要股东或实际控制人	国家集成电路产业投资基金股份有限公司:持股比例17.00% 芯电半导体(上海)有限公司:持股比例14.28%

3. 中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司

公司名称	中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司
公司性质	其他有限责任公司
法定代表人	高永岗
注册资本	3,000万人民币
成立日期	2014年2月27日
住所/主要办公地点	上海市虹口区广纪路738号1幢337室
主营业务	投资管理
主要股东或实际控制人	上海芯齐投资中心(有限合伙):持股比例35% 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司:持股比例19.51% 宁波道荣主投资管理有限公司:持股比例17.5% 宁波月湖香庄文化发展有限公司:持股比例17.5% 芯空间控股有限公司:持股比例10.49%

4. 凸版中芯彩晶电子(上海)有限公司

公司名称	凸版中芯彩晶电子(上海)有限公司
公司性质	有限责任公司(外商合资)
法定代表人	植木哲朗
注册资本	6,400万美元
成立日期	2004年11月24日
住所/主要办公地点	中国(上海)自由贸易试验区张江路18号2号楼1楼
主营业务	成像传感器的设计,晶圆彩膜的设计、生产、加工
主要股东或实际控制人	凸版印刷株式会社(日本):持股比例70% 中芯国际集成电路制造有限公司:持股比例30%

5. 灿芯半导体(上海)股份有限公司

公司名称	灿芯半导体(上海)股份有限公司
公司性质	股份有限公司(港澳台投资、未上市)
法定代表人	ZHIQING JOHN ZHUANG(庄志青)
注册资本	9,000万人民币
成立日期	2008年7月17日
住所/主要办公地点	中国(上海)自由贸易试验区张东路1158号礼德国际2号楼6楼
主营业务	集成电路设计服务
主要股东或实际控制人	中芯国际控股有限公司:持股比例23.48% NORWEST VENTURE PARTNERS X,LP:持股比例13.47% 嘉兴君柳投资合伙企业(有限合伙):持股比例5.93% BRITE EAGLE HOLDINGS,LLC:持股比例5.43%

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联人	与上市公司关联关系
1	盛吉盛(宁波)半导体科技有限公司	执行董事、首席财务官、执行副总裁兼公司秘书高永岗担任董事长
2	江苏长电科技股份有限公司	董事长、执行董事周子学担任董事长;执行董事、首席财务官、执行副总裁兼公司秘书高永岗担任董事;非执行董事任凯担任董事
3	中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司	执行董事、首席财务官、执行副总裁兼公司秘书高永岗担任董事长
4	凸版中芯彩晶电子(上海)有限公司	执行董事、联合首席执行官赵海军担任副董事长
5	灿芯半导体(上海)股份有限公司	执行董事、联合首席执行官赵海军担任董事长

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,双方交易能正常结算,前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司日常关联交易主要涉及原材料及设备采购、晶圆代工及封装测试服务、资产租赁等内容,交易价格均参照市场独立第三方同类交易的价格协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

1.公司控股子公司中芯长电半导体(江阴)有限公司与江苏长电科技股份有限公司签署了《厂房租赁合同》,协议期限为2014年12月1日至2024年11月30日,向长电科技租赁其位于江阴市城东厂区的部分厂房及配套通用设备。

2、公司全资子公司中芯国际控股有限公司与中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司签署了《租赁合同》,向中芯聚源出租场地用作办公用房,协议期限为2020年5月1日至2023年10月31日。公司全资子公司中芯晶圆股权投资(上海)有限公司与中芯聚源签署了《委托管理协议》及补充协议,委托中芯聚源管理其资产,协议期限为2019年9月5日至2029年2月26日。

3、公司全资子公司中芯国际集成电路制造(上海)有限公司与灿芯半导体(上海)股份有限公司签署《芯片代工框架协议》,约定灿芯向中芯国际订购的芯片将由中芯国际直接生产,产品名称、产品生产附加的特殊条款和条件包括技术规范等,应在单独的文件中列明,作为框架协议不可分割的一部分,协议期限为2019年5月4日至2022年5月3日。

4、公司全资子公司中芯国际集成电路制造(上海)有限公司与凸版中芯彩晶电子(上海)有限公司签署了《租赁合同》,向凸版出租厂房用作生产经营,协议期限为2020年8月1日至2023年7月31日。

除已签署协议外,公司与上述关联方将在董事会审议通过2021年度日常关联交易额度预计事项后,根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需,有利于促进公司相关业务的发展。

(二)关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方之间的交易是基于日常业务过程中按一般商业条款进行,关联交易定价公允,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

(三)关联交易的持续性

本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查,联合保荐机构海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司认为:

本次关联交易事项已经公司董事会审议通过,关联董事回避了表决,决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《经修订及重述组织章程大纲及章程细则》、《关联(连)交易管理制度》等相关规定;本次关联交易为公司正常经营活动所需,有利于促进公司相关业务的发展,关联交易基于日常业务过程中按一般商业条款进行,关联交易定价公允,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为,关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。联合保荐机构对公司2021年度日常关联交易额度预计事项无异议。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司董事会

2021年4月1日

A股代码:688981　A股简称:中芯国际　公告编号:2021-007

港股代码:00981　港股简称:中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司关于首次实现盈利暨取消股票简称特别标识U的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●取消股票简称特别标识后,公司A股股票简称由“中芯国际-U”变更为“中芯国际”,A股股票代码688981保持不变,取消特别标识不会对公司股票交易等方面产生影响。

●取消股票简称特别标识U的起始日期:2021年4月2日

一、取消股票简称特别标识U的情况说明

中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称“中芯国际”或“公司”)于2020年7月16日在上海证券交易所科创板上市,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》及《关于科创板股票及存托凭证交易相关事项的通知》等相关规定,公司2019年度归属于母公司股东的净利润为1,793,764千元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-522,095千元,属于上市时未盈利企业,因此自公司上市之日起A股股票简称特别标识为“中芯国际-U”。

公司2020年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,公司2020年度归属于母公司股东的净利润为4,332,270千元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,696,902千元;公司2020年年度报告已经公司董事会审议通过,并于2021年4月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《关于科创板股票及存托凭证交易相关事项的通知》等相关规定,公司2020年度归属于母公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为正,符合“上市时未盈利公司首次实现盈利”的情形,公司A股股票简称将于2021年4月2日取消特别标识,由“中芯国际-U”变更为“中芯国际”,A股股票代码688981保持不变。

二、其他事项的说明

根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》及《关于科创板股票及存托凭证交易相关事项的通知》,科创板股票简称特别标识是为特别提示公司是否具有上市时尚未盈利或具有表决权差异安排等情形,公司A股股票简称取消特别标识U不会对公司股票交易等方面产生影响。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司董事会

2021年4月1日

A股代码:688981　A股简称:中芯国际　公告编号:2021-009

港股代码:00981　港股简称:中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司关于2021年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●被担保人:被担保人为公司全资子公司和非全资控股子公司,其中全资子公司为中芯集电投资(上海)有限公司、中芯国际控股有限公司、中芯国际集成电路制造(上海)有限公司、中芯国际集成电路制造(北京)有限公司、中芯国际集成电路制造(天津)有限公司、中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司、中芯国际集成电路新技术研发(上海)有限公司、芯电半导体(上海)有限公司,非全资控股子公司为中芯京城集成电路制造(北京)有限公司。

●本次担保金额及实际担保余额:公司预计2021年度为子公司提供新增担保额度合计不超过人民币(或等值外币)4,700,000.00万元。截至2021年2月28日,公司已实际为本次担保对象提供的担保余额为1,285,417.44万元。

●本次担保是否有反担保:否

●本事项已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会进行审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称“公司”)根据其业务发展规划,并结合子公司的实际需求,预计2021年度为全资子公司和非全资控股子公司提供新增担保额度合计不超过人民币(或等值外币)4,700,000.00万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	被担保人	担保额度	公司持股比例
1	中芯集电投资(上海)有限公司	1,500,000	100%
2	中芯国际控股有限公司	20,000	100%
3	中芯国际集成电路制造(上海)有限公司	800,000	100%
4	中芯国际集成电路制造(北京)有限公司	800,000	100%
5	中芯国际集成电路制造(天津)有限公司	500,000	100%
6	中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司	500,000	100%
7	中芯国际集成电路新技术研发(上海)有限公司	20,000	100%
8	芯电半导体(上海)有限公司	10,000	100%
9	中芯京城集成电路制造(北京)有限公司	550,000	51%
	合计	4,700,000	

由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计,为确保公司生产经营的实际需要,在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性,公司可在授权期限内针对所属全部全资及非全资控股子公司(含现有、新设立或通过收购等方式取得)的实际业务发展需求,分别在上述全资子公司或非全资控股子公司的新增担保额度内调剂使用。

(二)本次担保事项履行的审议程序

公司于2021年3月31日召开董事会会议,审议通过了《关于2021年度对外担保额度预计的议案》。根据公司《经修订及重述组织章程大纲及章程细则》及《对外担保管理制度》的相关要求,本次担保事项无需提交公司股东大会审议。上述担保预计额度有效期为董事会审议通过之日起12个月。

二、被担保人基本情况

(一)中芯集电投资(上海)有限公司

1、成立日期:2020年9月30日

2、注册资本:46,580万美元

3、注册地点:中国(上海)自由贸易试验区张江路18号

4、法定代表人:周子学

5、经营范围:在国家允许外商投资的领域依法进行投资;集成电路相关电子产品的研发、生产(由分支机构经营);受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过),向其所投资企业提供下列服务:(1)协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;(2)在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇;(3)为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务;(4)协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。在中国境内设立科研开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研究开发,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务;为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务;承接其母公司和关联公司的服务外包业务;集成电路产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关配套业务;自有物业出租。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

6、主要财务数据:

单位:千元

|